证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-028

浙江铖昌科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946号）核准，公司于2022年6月6日首次公开发行人民币普通股27,953,500股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行数量为2795.35万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.68元，募集资金总额606,031,880元，扣除发行费用后募集资金净额509,105,900元。该次募集资金已于2022年5月30日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000315号）对上述资金到位情况进行了确认。

截至2025年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币443,612,756.67元，其中以前年度使用364,463,491.47元，本年度使用79,149,265.20元。截至2025年12月31日，募集资金专户结余金额人民币78,809,030.63元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于2022年6月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	银行	账号	账户余额
1	浙江铖昌科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	635252302	9,222,214.45
2	浙江铖昌科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳高新支行	955088940913430329	69,586,816.18
		合计		78,809,030.63

三、募集资金的实际使用情况

2025年本公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表1 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			50,910.59			本年度投入募集资金总额		7,914.92			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		44,361.28			
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目	否	39,974.26	39,974.26	6,245.09	33,816.70	84.60%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目	否	10,936.33	10,936.33	1,669.83	10,544.58	96.42%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,910.59	50,910.59	7,914.92	44,361.28	87.14%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	-		-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		-	-	-	-	-			
合计	-	50,910.59	50,910.59	7,914.92	44,361.28	87.14%	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、自募集资金到位以来，公司管理层积极推进募投项目实施，并积极把握行业发展趋势，布局重点战略领域。随着募投项目的实施，公司参与的多个研制项目不断进入量产阶段，星载、地面领域各类型应用T/R芯片项目保持持续批量需求，机载应用领域也快速拓展，产品结构不断丰富。公司目前仍需要进一步加大研发投入，持续进行T/R芯片解决方案的迭代研制以满足日益增加的新产品开发需求，为公司营收增长提供有力支撑。公司基于审慎原则，结合当前市场总体环境、公司发展战略以及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，公司对募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行调整，并经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，同意将上述募投项目预定可使用状态调整至2025年12月31日。 2、募集资金到位以来公司审慎使用募集资金，项目涉及的设备购置、晶圆流片、购置经营场所等各项投入有序开展，募集资金投资进度与原计划存在差异，项目无法在计划的时间内完成投资。为确保募集资金投资项目的稳步推行，公司基于审慎原则，将“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”预计可使用状态日期由原定2025年12月31日调整至2026年12月31日。 上述募投项目预计可使用状态日期变更后，公司各募投项目的总体实际投资进度与计划进度基本吻合，不存在实际投资进度大幅低于新的投资计划的情形。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	为匹配未来业务发展，公司已迁至新的生产经营场所，并于2024年1月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目的实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项。公司将募投项目“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”及“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”实施地点由“杭州市西湖区西园三路3号杭州智慧产业创业园5幢3楼”变更为“杭州市西湖区智强路428号云创铼谷研发中心3号楼”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、公司于2024年1月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目的实施地点、实施方式并调整内部投资结构的事项。公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，主要为项目中的“设备购置及安装费”“人员薪酬”“研发软件、模具、晶圆流片材料费用”有调整变动，项目总投资额不变。 2、公司于2024年8月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构及实施进度，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变，主要为项目中的“设备购置及安装费”“人员薪酬”“研发软件、模具、晶圆流片材料费用”有调整变动，项目总投资额不变；对募集资金投资项目的预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。 3、公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十三次会议、审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意将“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”预计可使用状态日期由原定2025年12月31日调整至2026年12月31日。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274号）。 2023年3月27日，公司召开的第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。2025年度，拟置换以自有资金支付的人员薪酬3,943.90万元，其中超过6个月未完成置换的改由自有资金支付，实际置换1,471.72万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 报告期内，公司购买“物华添宝”W款2025年第3期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)4,000万元，持有时间为2025.7.8-2025.9.8，投资收益为133,172.60元；公司购买物华添宝”W款2025年第122期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)4,000万元，持有时间为2025.9.19-2025.12.18，投资收益为229,315.07元。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2025年12月31日，公司募投项目“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，募集资金节余391.75万元（不含利息）。										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-025

浙江铖昌科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以206,114,901为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST铖昌	股票代码	001270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	铖昌科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵小婷	朱岭瑶	
办公地址	浙江省杭州市西湖区智强路428号云创铼谷研发中心3号楼	浙江省杭州市西湖区智强路428号云创铼谷研发中心3号楼	
传真	0571-81023659	0571-81023659	
电话	0571-81023659	0571-81023659	
电子信箱	ccir@zjcckj.com	ccir@zjcckj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

2025年，中国集成电路行业在人工智能需求拉动、消费电子回暖及国产替代提速的多重驱动下，展现出强劲的发展势头，重回高速增长区间，有望成为驱动新质生产力的关键引擎，为数字经济高质量发展贡献力量。据中国半导体行业协会集成电路设计分会发布的数据，2025年集成电路设计企业全行业销售额预计达8,357.3亿元，同比增长29.4%，首次突破千亿美元大关，占全球集成电路市场份额同比有所提升。与此同时，产业升级与整合的步伐加快，在政策红利释放与产业升级需求双重驱动下，集成电路企业的并购重组数量显著增加，有助于提升产业集中度与核心竞争力。

近年来，在政策扶持、技术进步及市场需求驱动下，中国集成电路行业市场规模持续增长，投融资热度攀升，国产替代进程加速，展现出强劲的发展势头和广阔的发展前景。制造端的产能满载、技术迭代与下游需求回暖、库存回归健康形成合力，共同推动国内集成电路的产业链各环节呈现了量价齐升发展态势。工信部发布的最新数据显示，2025年我国集成电路产量4,843亿块，同比增长10.9%。

2026年政府工作报告中明确提出，要加紧培育壮大新动能，将集成电路产业放在新兴支柱产业首位。围绕加快高水平科技自立自强，报告中提出“发挥新型举国体制优势，全链条推进关键核心技术攻关”等工作部署，为集成电路产业提质增效指明方向、注入强心剂。在全球产业链重构趋势与我国政府在产业、人才、税收等各方面的政策扶持下，我国集成电路制造和配套产业链加速迈向规模化和高端化新阶段。

1、主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为微波毫米波相控阵T/R芯片（以下简称“T/R芯片”）的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于硅基、砷化镓以及第三代半导体氮化镓工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案。公司产品T/R芯片是相控阵天线系统的核心元器件之一，广泛应用于模拟、数字、混合相控阵阵列中，性能则直接影响整机的各项关键指标。

相控阵天线体制是一种通过计算机精确调控各辐射单元相位分布，实现波束指向瞬时重构与空域扫描的先进天线技术。该体制下，每个辐射单元均配装独立的发射/接收组件，集成功率放大器、低噪声放大器及幅相控制等芯片，使其具备独立发射与接收电磁波的能力，从而生成精确可预测的辐射方向图和波束指向。与传统机械扫描天线相比，相控阵系统突破惯性约束，具备波束切换快速精准、宽频带多频段兼容、多目标跟踪能力强、信号处理效率高、冗余设计优及可靠性高等显著优势。这使得基于相控阵体制的无线电子信息系统成为当前及未来先进无线系统的主流发展方向，广泛应用于探测、遥感、通信、导航等领域，并逐步拓展至航空航天通信、气象水利雷达、低空经济、交通网络等新兴应用场景。

作为国内少数能够提供T/R芯片完整解决方案的企业之一，公司产品全面覆盖固态微波产业链核心环节，形成了品类丰富、性能领先的产品矩阵。主要产品涵盖GaAs/GaN功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs收发前端芯片、收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等十余类高性能微波毫米波相控阵芯片，目前公司产品达上千种，频率范围可覆盖L波段至W波段。凭借深厚的技术积累和稳定的产品性能，公司产品已在星载、地面、机载相控阵雷达及低轨卫星通信等领域实现批量应用，并有力支撑了国家相关重要项目的建设需求。

随着下游装备向小型化、轻量化、高集成和低成本方向加速演进，T/R芯片作为相控阵雷达、天线系统的核心元器件，其性能水平直接决定整机装备的关键指标及效能。面对集成度、功耗、效率等方面的更高要求，公司将坚持以技术创新为驱动，持续加大研发投入，聚焦高频化、高集成度、轻量化及多功能化等关键技术方向，深度布局行业前沿技术研究，不断提升产品核心竞争力，致力于为客户提供更先进的相控阵芯片解决方案，巩固并扩大公司在行业内的领先优势。

（1）相控阵雷达领域

相控阵雷达的探测能力与阵列单元数量密切相关，一部相控阵体制装备可由几十到数万个阵列单元组成。随着下游装备小型化、轻量化、高集成、低成本的发展需求，对T/R芯片的集成度、功耗、效率等技术指标也提出了高要求。公司经过十几年技术积累与升级，所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点，并已形成上千种产品，产品通过严格质量认证，质量等级可达宇航级。

公司早期便深耕星载相控阵技术研发与市场布局，参与多项国家重点项目，推出的星载T/R芯片产品在多系列卫星中实现了大规模应用，显著提升了卫星雷达系统的综合性能，获得客户高度认可，双方合作持续深化，由此奠定了公司在星载领域核心供应商的领先地位。公司不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量，随着下游需求恢复，多系列遥感星座项目公司产品已陆续进入持续批量交付阶段。

公司在机载领域的产品，以面向通信应用场景的相控阵天线T/R芯片为核心，主要用于支撑机载系统感知能力与体系化建设。近年来，该板块业务规模快速放量，公司前期布局的多个重点项目已陆续进入批量供货阶段。公司与下游客户建立了深度配套合作关系，有力保障了项目高效推进。报告期内，客户持续下达新增订单与合同，公司积极统筹产能保障交付，机载领域营收保持了高速增长，机载领域T/R芯片产品已成为公司主要营收部分之一。

公司的地面领域产品主要为各类型地面雷达T/R芯片，其中大型地面雷达具有相控阵阵面大、T/R通道数量多、探测距离远的特点，公司产品第三代半导体氮化镓功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、高功率密度等多方面优势，可满足高功率相控阵雷达的应用场景，已规模应用于地面领域；另外小型化相控阵T/R芯片具备良好的目标探测、抗干扰和实时处理性能优势。随着下游需求计划在陆续落地，公司根据下游需求计划进行备货及生产交付。

（2）低轨卫星通信领域

当前，我国卫星通信产业正处于政策强力驱动、建设加速推进、应用逐步大众化的关键发展期，加快推进低轨卫星互联网建设、带动产业链上下游协同创新、实现全球宽带网络全域覆盖，已成为重要发展任务。目前，我国低轨卫星互联网建设已取得实质性突破，正从技术验证阶段全面转向规模化应用阶段。通过卫星通信技术大规模组网，加快构建空天一体化服务体系，推动通信基础设施向全域化、智能化升级。其中，相控阵天线凭借高增益特性与动态波束调控能力，成为提升信号传输质量与用户使用体验的核心环节，是技术演进的关键方向，在卫星通信领域的市场需求前景广阔。

公司在卫星通信领域具备先发优势，领先市场推出星载和地面用卫星通信T/R芯片全套解决方案，研制的多通道多波束幅相多功能芯片为代表的T/R芯片，在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备一定的优势。报告期内，公司保持该领域领先优势，与产业下游用户合作关系紧密，针对下一代低轨通信卫星以及地面配套设备新研发出多款产品，完成卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，目前这些产品已在依据客户需求备货并按计划批量交付，为进一步扩大市场份额做好相关储备。

2、经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（1）采购模式

公司主要原材料为晶圆，根据产品的获取渠道不同，公司采购模式分为两种：一是通过经晶圆流片厂认证的第三方代理商向晶圆流片厂进行采购；另一种方式为直接向原厂采购，公司的部分晶圆和生产辅助材料是直接向原厂采购，根据项目的生产计划，确定采购需求量。

（2）生产模式

公司产品生产流程主要包括晶圆流片、电性能测试、外观检验、划片、可靠性验证等多项环节，其中晶圆的流片、划片主要采用代工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆流片厂进行晶圆流片，经公司测试后，再由划片厂进行划片。

（3）销售模式

公司主要采用直销模式，营销中心根据公司的业务发展规划进行市场开拓、产品销售、客户维护，对研发、生产进度进行监督和协调，另外还负责相关销售合同的签订回款及项目管理。

公司的主要销售模式为：①营销中心积极了解和响应下游的项目进展及配套需求，与客户沟通并明确需求；②利用公司的技术和服务优势，参与项目产品型号的研发，为其研发符合需求的解决方案；③方案经公司内部评审通过后，形成产品报价和技术方案，与客户进行技术评审和商务谈判；④与客户达成合作意向后签订相关协议；⑤以客户需求为前提，公司营销、研发、生产部门制定相关计划，合理有效的组织研发设计、采购、生产、交付及项目管理工作。

（4）研发模式

公司的研发项目分为两大类，第一类是来源客户的研发任务，根据与客户签订的明确的产品和技术服务需求，组织研发团队，研发出满足客户需求的解决方案；第二类是公司自行确定的研发任务，根据产品技术发展趋势及未来潜在的市场需求，组织研发团队进行新产品和新技术的研发。

公司的主要研发流程为：①研发中心对项目情况、技术路径、经费预算、研发时间计划等各项指标进行可行性分析，经公司内部充分论证，评审通过后形成立项报告；②围绕客户的技术要求，梳理设计技术方案，包括产品功能、工艺、可靠性等技术参数，形成设计报告；③由研发中心负责组织进行测试，包括功能、性能等测试，形成测试报告；④对于测试检验结果，各项指标性能符合要求即可提交评审验收。项目研发结束后，准备项目验收评审相关工作。

3、公司市场地位

公司市场定位清晰，自成立以来专注于T/R芯片设计开发，经过十余年的研究发展，公司技术积累深厚，产品水平先进，在T/R芯片领域已具有较为突出的实力，是国内从事T/R芯片研制的主要企业之一，目前国内具有T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业。

公司作为少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业，一直致力于推进T/R芯片的自主可控，并积极促进T/R芯片在相关领域的低成本、大规模应用，在供应商资质、产品工艺设计、质量管理能力等多方面已经具备先发优势，在行业内形成了较高的知名度和认可度。近年来相继参与多项国家重点项目并通过严格质量认证，先后参与多家大型集团科研院所及下属企业的产品开发工作，已与下游主力客户形成深度的合作配套关系，相关产品也已广泛应用在国家多个重大项目中，被评定为国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省“隐形冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业，承建浙江省重点企业研究院、浙江省重点实验室等。

公司将积握市场动态与国家政策导向，持续深化高质量发展路径。通过持续加大核心技术研发投入，不断提升自主创新能力与产品核心竞争力；积极拓宽各下游应用领域的市场布局，持续提升品牌知名度与行业影响力；同时全面优化内部资源配置与运营管理效率，巩固并强化规模化成本优势；公司将重点深化与核心客户的战略合作，强化业务协同与需求对接，不断提升客户黏性与合作深度，进一步夯实主营业务的竞争壁垒与市场基础，巩固并持续提升行业领先地位，实现稳健可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,635,065,202.76	1,504,087,689.14	8.71%	1,480,571,926.51
归属于上市公司股东的净资产	1,509,807,402.04	1,366,695,580.72	10.47%	1,408,183,808.65
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	404,622,960.22	211,539,009.02	91.28%	287,353,971.81
归属于上市公司股东的净利润	117,109,847.25	-31,117,893.52	476.34%	79,707,857.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,336,666.71	-43,613,965.50	336.93%	69,911,116.06
经营活动产生的现金流量净额	-47,363,636.15	-47,571,089.62	0.44%	-14,482,731.41
基本每股收益（元/股）	0.5755	-0.1529	476.39%	0.3917
稀释每股收益（元/股）	0.5638	-0.1529	468.74%	0.3917
加权平均净资产收益率	8.14%	-2.26%	10.40%	5.76%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,008,850.60	109,200,249.12	104,886,716.29	98,527,144.21
归属于上市公司股东的净利润	29,815,883.20	26,817,458.90	33,725,284.96	26,751,220.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,825,992.10	25,961,418.64	33,246,639.03	15,302,616.94
经营活动产生的现金流量净额	-87,522,482.55	7,242,259.53	-25,854,778.33	58,771,365.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,685	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳和而泰智能控制股份有限公司	境内非国有法人	46.63%	96,101,270	0	不适用	0
丁宁	境内自然人	1.44%	2,975,966	0	不适用	0
丁文恒	境内自然人	1.38%	2,843,887	0	不适用	0
海南文昌科祥投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,306,400	0	不适用	0
海南文昌科吉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	2,203,251	0	不适用	0
杭州铖锴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	2,073,469	0	不适用	0
刘闯	境内自然人	0.90%	1,856,700	0	不适用	0
海南文昌科麦投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,823,570	0	不适用	0
李东璘	境内自然人	0.65%	1,348,800	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.58%	1,202,618	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

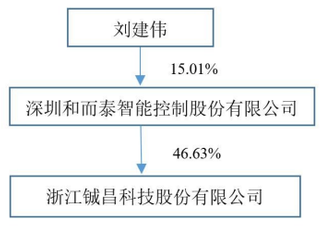
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司股票交易被实施退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项之规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-31,117,893.52元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-43,613,965.50元，扣除后营业收入为211,539,009.02元，触及上述《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定的情形，公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2026）第00006369号）显示，公司2025年度经审计的利润总额为115,271,371.22元，净利润为117,109,847.25元，扣除非经常性损益后的净利润为103,336,666.71元，扣除后的营业收入为404,622,960.22元，期末归属于上市公司股东的净资产为1,509,807,402.04元。

经自查，公司2025年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条之规定，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，并于2026年4月16日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司授予预留部分限制性股票

2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意以2025年4月21日为预留授予日以19.76元/股的价格向37名激励对象授予预留部分共计39万股限制性股票。公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记的工作，本次激励计划预留授予登记人数为37人，预留授予登记数量为39万股，授予价格为19.76元/股。该部分股票于2025年6月16日在深交所上市。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-027

浙江铖昌科技股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“铖昌科技”）于2026年4月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司根据业务发展及实际经营情况，2026年度预计将与公司参股公司浙江集迈科微电子有限公司（以下简称“集迈科”）发生日常关联交易，关联交易连续12个月内合计不超过3,000万元人民币。公司2025年度实际发生的日常关联交易总金额为1,026.37万元。

2、2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品及技术服务支持	集迈科	晶圆采购及委托加工	参考市场价格	3,000	236.02	1,026.37

3、2025年度日常关联交易实际情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品及技术服务支持	集迈科	晶圆采购及委托加工	1,026.37	2,000	7.03%	48.68%	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2025-014
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原因所致。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易以市场价格为定价依据进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。						

注：关联交易预计金额及实际发生额均以实际发生为准。

二、关联人情况和关联关系

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	浙江集迈科微电子有限公司
统一社会信用代码	91330522MA2B5RJY7N
法定代表人	马飞
成立时间	2018年9月30日
注册资本	7536.0034万元人民币
注册地	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴国家大学科技园二分部北园8号厂房
经营范围	生产：半导体集成电路和系统集成产品；化合物半导体芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：电子产品，机电设备及配件，计算机软硬件及配件；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：集成电路封装与系统集成技术；集成电路测试技术；集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成	公司持有5.00%的股权，其他股东持有95.00%的股权
主营业务	高可靠性射频微系统（含微波组件）和氮化镓器件等产品的工艺开发、流片代工以及特种封装业务等

最近一期财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产31,227.79万元、净资产25,057.81万元、营业收入6,142.09万元、净利润-7,988.14万元。

2、与上市公司的关联关系

集迈科为公司参股公司，公司持有集迈科股权比例为5.00%，公司控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司持有集迈科股权比例为7.01%。

3、履约能力分析

集迈科依法存续经营，综合其最近一期的主要财务数据，集迈科生产经营及财务状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与集迈科之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与集迈科将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

五、专项意见说明

1、独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提供的《关于2026年度预计日常关联交易的议案》及相关资料，认为公司预计的2026年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体